



# 搬送時の粉塵少なく

## 三木 ポリマー 半導体部品向けトレイ

【神戸】三木ポリマー（神戸市西区、圓山登志夫社長、078・969・1601）は、LSIなど半導体部品の搬送用に金属と樹脂を組み合わせた工程用トレイ「ミキトレ

イ」写真を開発した。価格は4000～5000円。半導体や水晶デバイスメーカー向けに初年度1000枚を販売。2015年度に6万枚、売上高約3億円を目指す。

ミキトレイはアルミやステンレスなどの金属板に耐熱性、耐摩耗性に優れたポリエーテル・エーテル・ケトン（PEEK）を射出成形して枠を生成した。大きさは約100

ミキ角。樹脂で固める前の半導体チップやクリスタル単体の搬送に適している。金属製に比べ価格を半額程度、重さも約65

%の57%と軽量化し持ち運びを容易にした。低価格の変性ポリフェニレンエーテルを使ったプラスチック製トレイに

比べて本体の反りなどの変形がないという。樹脂部分が少なく、搬送時の振動摩擦による粉塵の発生も抑えた。